

2021第二十三届高交会 在深圳召开 中国国际高新技术成果交易会

产品名称	2021第二十三届高交会 在深圳召开 中国国际高新技术成果交易会
公司名称	上海钧泽展览有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区城桥镇运粮小区288号3幢108-5（崇明森林旅游园区）（注册地址）
联系电话	18601696105

产品详情

2021第二十三届高交会 在深圳召开 中国国际高新技术成果交易会

2021深圳国际半导体封装测试技术大会暨展览会

时间：2021年11月17日-19日 地点：深圳会展中心

活动地点：深圳会展中心（3号馆）

展览时间

报道布展：2021年11月12-16日（五天）开幕式：2021年11月17日

展览展示：2021年11月17-21日（五天）撤展：2021年11月21日

国际化、便利化、高水平的科技成果交流平台

共同举办单位：中华人民共和国商务部

中华人民共和国科学技术部

承办单位：深圳市中国国际高新技术成果交易中心

深圳会展中心管理有限责任公司

协办单位：广东省半导体行业协会

组织单位：尹宸会展服务(上海)有限公司

展会介绍

半导体是当今信息技术产业高速发展的源动力，《中国制造2025》中将半导体产业放在发展新一代信息技术产业的首位。中国作为全球。大的半导体消费市场，中国半导体产业面临着前所未有的发展机遇，只有抓住这个时间窗口才能重新定义全球市场格局。“2021深圳国际半导体封装测试技术大会暨展览会”将于2021年11月17-21日在深圳会展中心隆重举办，经过多年的发展，已成为国内外具有一定影响力的半导体业界盛会。涵盖了半导体技术制造的各个方面，包括设备、设计、光刻、集成、材料、流程、制造以及新兴半导体科技和硅材料应用等。除此之外，各大公司高层代表们齐聚一堂，聚焦行业热点话题，就LED、半导体材料以及微电子机械系统等进行探讨和交流。为从事集成电路设计、芯片加工、封装测试、半导体专用设备、半导体专用材料、半导体分立器件的海内外厂商，企事业单位搭建了一个展示新成果，打造产品品牌的平台。而且聚焦产业政策解读，涵盖“体制创新、模式创新、技术创新”等内容的高峰论坛和专题研讨会，在业界有着。。的口碑和。。度。

作为全球。具规模及影响力的国际半导体领域年度盛会，本届展会将以“国际化、。。化、高层次”的会议要求，邀请日本、韩国、美国、法国、英国、德国、芬兰等欧美地区及中国大陆/港台地区半导体产业巨头，共同探讨交流中国半导体行业之发展。本届展会是顺应产业发展的趋势，服务于十几个新兴行业应用。将邀请AI、自动驾驶、物联网、5G通信、智能终端、智能传感等数十个新兴应用领域。。芯片半导体企业展示新的解决方式，推动半 导体产业与新兴应用市场有效结合，邀请终端大企业用户参观交流，引领设计、制造、封测、材料和设备厂商开展合作与对话，打造热门细分市场和新兴应用终端客户以及半导体产业链紧密合作交流的。。平台。

“2021深圳国际半导体封装测试技术大会暨展览会”作为“2021第二十三届中国国际高新技术成果交易会（高交会）”重要组成部分，除活动自带流量外，同时共享高交会展来自人工智能、智能家居、智能制造、物联网、智能驾驶、车联网、5G商用、8K超高清、新一代信息技术、大数据、云计算、应急安全、光电显示等行业展会5天内45.1万人次观众现场参观了大会，加强半导体行业产业链建设、行业快速发展及广泛交流合作提供强有力的合作平台。

展览面积 14.2万 3349家 观众45.1万 同期活动 176

论坛演讲

半导体行业评选与颁奖活动

受大会承办单位机构委托开展半导体评选与颁奖活动，此次评选为企业自主申报，评选板块从：技术、应用、芯片与器件等四大类，来自相关行业协会、社区运营、评测机构、权威媒体等20多位专家按照技术性、市场竞争性、环保低功耗、性能稳定性等指标进行严格评审，并评选出行业奖项20项，并在大会开幕之际邀请中国商务部、科技部、工信部、国家发改委、中国科学院与行业协会相关领导颁发奖项，对行业杰出贡献的企业、个人、媒体等进行表彰，并刊登在相关行业媒介上。

评选奖项：（拟）

明星项目 智能芯片金奖 半导体行业贡献奖

集成电路设计杰出贡献奖 半导体。。应用奖。。 半导体服务商金奖

半导体材料。。企业奖 半导体MEMS。。奖。。 半导体节能奖

。。 半导体封装测试奖。。 半导体功率器件奖。。 半导体MEMS奖

。。 创新奖

展览会亮点

- 1.覆盖半导体领域全产业链，聚焦行业应用，为制造商提供新思路及解决方案，终端买家对接。
- 2.依托深圳高交会资源带来强大科研购买力，汇聚高校，科研院所，重点实验室，工程中心，技术开发机构。将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。
- 3.将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。
- 4.高端论坛聚焦前沿，论坛水准及规模得到业内极大认可，内容覆盖半导体、5G技术、芯片技术、人工智能、智能家居、智能制造、物联网、智能驾驶、车联网、5G商用、8K超高清、新一代信息技术、大数据、云计算、应急安全、光电显示等。来自不同行业听众将带来各种应用需求。

展览范围：半导体设计、封测、制造产厂商。

原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩模版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；

生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD、光刻机、蚀刻机、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片沉积系统、清洗设备；

封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机、焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等；

测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、流量控制、石英石墨、碳化硅等；

观众来源

- 1、航空航天，船舶制造，汽车工程，仪器设备工程技术，通用工程技术，电子电气行业，IT产业，通讯行业，医疗，化工，石油煤炭、能源、冶金、家电及消费电子（手机、穿戴、移动产品、VR/AR）、汽车电子、物联网应用、智能家居、智慧养老、智慧城市、物联网应用、高端装备、智能制造、机器人、工业自动化、军工电子、轨道、交通、能源化工、5G通信、机器人机床等。
- 2、科研院所、高校、研发机构、行业协会、产业联盟、工业园区、高新区、产业基地、孵化器机构等。
- 3、国家有关部委及各省市政府、各驻中国商会、行业协会商会、进出口贸易公司、投资机构等

上届回顾

中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）由中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）由中

国商务部、科技部、工信部、国家发改委、农业农村部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院等部委和深圳市人民政府共同举办，每年在深圳举行，是目前中国规模大、具影响力的科技类展会，2020年高交会以“共建活力湾区，携手开放创新”为主题，组织展览展示、会议论坛、技术交流、合作洽谈，努力发挥高交会在助推产业转型升级，深化国际科技交流合作，促进创新创业等方面的积极作用，进一步强化高交会“行业风向标”“技术风向标”、“创新风向标”的作用。